

銅バンプ付きプリント配線板 技術資料



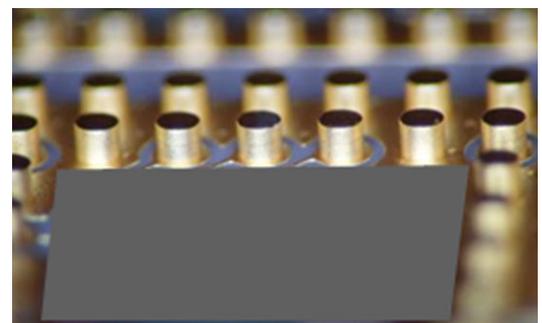
● 概要

半導体チップの表裏実装を可能にする銅バンプ付きプリント配線板です。
バンプピッチの高密度化に優れ、モジュールの接続信頼性向上が期待できます。

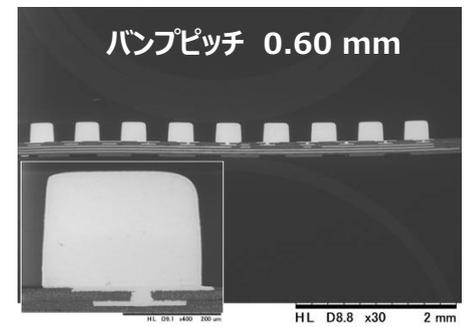
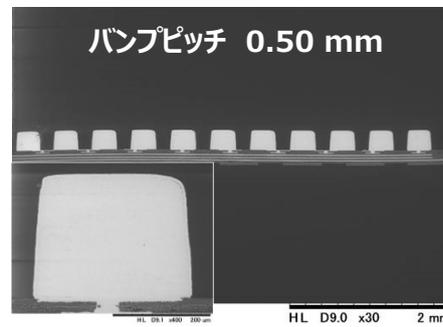
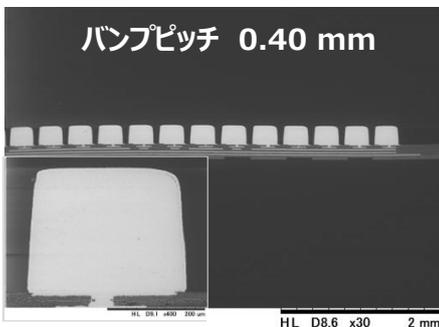
● 設計仕様

| 項目 | 単位 | 仕様 |
|--------------|------|-----------|
| バンプ高さ | mm | 0.25±0.03 |
| バンプピッチ[Min.] | mm | 0.40 |
| バンプ径[Min.] | mm | 0.20 |
| バンプ高さ公差 | % | (10~15) |
| バンプ形状 | type | 四角柱、円柱 |

[バンプ写真]

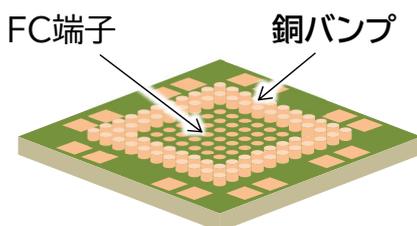


● 各バンプピッチ断面写真

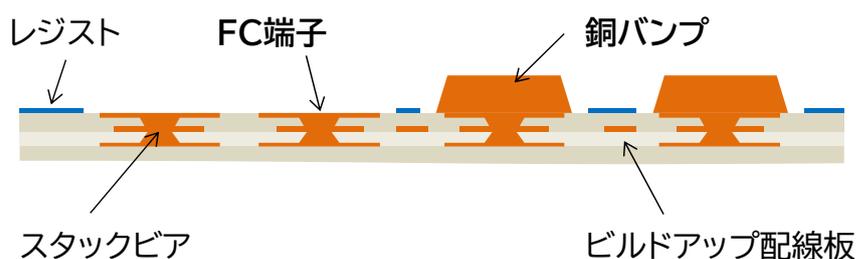


● 用途例

● 通信モジュール



● 製品断面図:同一面上にFC端子とバンプの形成が可能



● お願い

製品の仕様を満足させるため、お客様と事前に設計打合せを実施させていただきます。